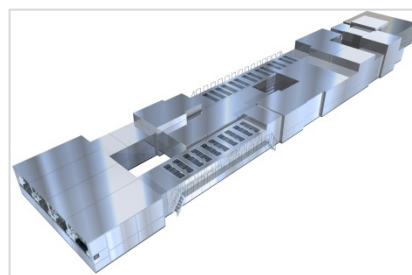


株式会社 SCREEN ファインテックソリューションズ

## 有機ELパネルの製造に特化した装置を開発 ～第1弾として第6世代対応塗布現像装置の販売を開始～

株式会社SCREENファインテックソリューションズはこのほど、有機ELパネルの製造に特化した製品「Eシリーズ」を開発。その第1弾として、第6世代基板対応の有機ELバックプレーン製造工程用コーターデベロッパー「SK-E1500G」とタッチセンサーパネル(TSP)製造工程用コーターデベロッパー「SK-E1500H」を、11月から販売します。



### SK-E1500G/H

☆この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、  
下記URLよりダウンロードできます。

([www.screen.co.jp/press/download/FT171115.zip](http://www.screen.co.jp/press/download/FT171115.zip))

有機ELディスプレイは、画質の高さや、フレキシブル化が可能なことなどから、スマートフォンをはじめとするモバイル端末やテレビを中心に需要が急速に拡大しており、2020年の市場規模は、現在の1.5倍となる480億ドル<sup>※1</sup>に達すると予測されています。しかし、有機ELパネルの製造段階においては、有機汚染対策や微小なごみの制御、静電気のコントロールが難しく、安定した供給の実現が課題となっています。

このような状況を受け当社は、世界トップシェアの液晶ディスプレイ用コーターデベロッパーで長年培ったノウハウを基に、有機ELパネルの製造に特化した製品を開発しました。今回発売する「SK-E1500G」と「SK-E1500H」は、第6世代と呼ばれる1,500mm×1,850mmの基板に対応した塗布現像装置で、製造工程において発生するガス・薬液成分などの浮遊物による汚染や静電気を徹底して抑制する、ミニエンバイロメント<sup>※2</sup>技術を確立。基板の汚染を低減することにより、歩留まりの向上を実現しました。また、有機EL製造プロセスにおいて必須となる2種類の薬液(フォトレジスト)に対応した、2ノズルタイプの浮上搬送方式スリット塗布装置「レビコータ」を標準搭載。ガラス製支持基板の薄板化<sup>※3</sup>、TFTの微細化<sup>※4</sup>にも対応可能なため、多様化するデバイス製造プロセスに適した装置となっています。さらに、「SK-E1500H」は高度な基板搬送技術により、第6世代のハーフ基板<sup>※5</sup>の2枚同時処理を可能とし、生産効率の向上に寄与します。

当社は今後、「Eシリーズ」の装置ラインアップを拡充し、有機ELパネルの安定した量産に貢献していきます。

※1 当社調べ

※2 周囲の清浄度よりも著しく高い局所的清浄環境を設置するクリーンルーム方式の一つ。

※3 厚さ0.3mmに対応

※4 線幅/線間隔(L/S) 1.5 $\mu$ m以下に対応

※5 TSP製造工程において、前工程である蒸着工程で処理できる基板サイズは、最大で第6世代の2分の1となるため。

#### ● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREENファインテックソリューションズ 事業推進部 Tel: 075-417-2570 [fpdinfo@screen.co.jp](mailto:fpdinfo@screen.co.jp)